

台灣發明商品促進協會 函

地址：台北市松山區八德路二段400號7樓
承辦人：賴淑玲
電話：02-8772-3898
電子信箱：wiipal68@wiipa.org.tw

受文者：國立清華大學

發文日期：中華民國113年9月18日

發文字號：字第1130091802號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(文稿1_0091802A00_ATTCH1.docx、文稿1_0091802A00_ATTCH2.pdf)

主旨：敬邀 貴校師生參加「2025日本東京設計創意暨發明展」。

說明：

一、「2025日本東京設計創意暨發明展」將於114年7月5日~7月6日在東京舉行，這是青年發明家和新銳設計師，促進國際交流與商業合作的最佳平台，敬邀 貴校師生參賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍參加。

二、即日起報名至114年5月31日止，洽詢專線(02)8772-3898分機19賴小姐或email至wiipal68@wiipa.org.tw。

正本：國立臺灣海洋大學、國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立陽明交通大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、東吳大學、中國文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北醫學大學、康寧學校財團法人康寧大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北護理健康大學、國立臺北商業大學、國立臺北大學、國立臺灣藝術大學、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、華梵大學、真理大學、國立體育大學、國立中央大學、中原大學、長庚大學、元智大學、開南大學、國立清華大學、玄奘大學、中華大學學校財團法人中華大學、國立聯合大學、國立臺中教育大學、國立臺灣體育運動大學、國立中興大學、國立中興大學計算機及資訊網路中心、東海大學、逢甲大學、靜宜大學、中山醫學大學、亞洲大學、國立彰化師範大學、大葉大學、明道學校財團法人明道大學、建國科技大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立中正大學、南華大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、長榮大學、國立中山大學、國立高雄師範大

國立清華大學



1130019079

學、國立高雄大學、義守大學、高雄醫學大學、國立屏東大學、國立金門大學、
國立宜蘭大學、佛光大學、國立東華大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、國立臺
東大學、國立空中大學、高雄市立空中大學

副本：



施養隆 會長

裝

訂

線